



产品简介

- 芯片围坝胶KXS5661是一种单组分环氧胶，可低温固化，模量较低的环氧树脂胶粘剂。该胶粘剂具有较高的触变性，温度特性，润湿特性等，非常适合应用于SMT工艺，胶点形状非常容易控制，储存安定性好，且具有优良的耐热冲击性和优良的电气特性。

典型性能

- 触变高
 - 粘结性好
 - 绝缘性能优异
 - 可低温固化
- 联系我们：张 艳：138-5168-3378；荣 岩：180-6607-5325；
田晓冰：152-5095-2541；许飞艳：132-7663-5250；杨慧子：159-9624-3638

固 化 前	测试项目	KXS5661	
	外观	黑色	目视
固 化 后	粘度 (25℃, cp)	170000±10000mPa•s	ASTM D 2196
	适用时间 (25℃)	3天	-
	固化时间(100℃)	30min	-
	硬度 shore D	85	GB/T 2411-2008
	介电强度 KV/mm	≥15	ASTM D149
固 化 后	体积电阻率 Ω.cm	≥10 ¹⁴	GB/T 1410-2006
	过260℃波峰焊拉拔强度保留初始强度的百分比%	100	TM-650 2.4.42
	剪切强度 MPa (Al/Al)	≥10.0	GB/T 7124-2008
	耐温范围 °C	-50 ~ 200	-

使用方法：

- 打开包装之前，确保包装完整、无破损、产品在使用期内。
- 从冰箱取出后，在解冻时将注射器垂直放置；回温至25℃，开封前务必清除水汽。
- 已使用的产品不可倒入未使用的原包装产品中，避免污染；解冻后的产品避免重新冻结。
- 建议使用本资料中推荐的固化工艺进行固化。

包装、储存与运输：

- 塑料管包装，10cc、30cc、55cc、200cc支装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项：

- 对于高强度的结构粘接，去除表面的污染物，如油漆，氧化膜，油、灰尘，脱模剂和所有其他表面污染物；
- 使用手套，尽量减少皮肤接触，不要用溶剂清洗双手；
- 为获得更大的粘接强度，推荐双面涂胶并且材施工注意事项之间的粘接间隙在0.08-0.13mm之间；
- 固化过程中采用适当夹具并且保证不要产生粘接部件之间的相对位移，固化前清楚多余的余胶；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。

